

Tiratura **Print-run** 8.848 Diffusione **Circulation** 8.490

Certificato CSST n. 2007-1561

Qualità della diffusione certificata da BVQI (Bureau Veritas Italia)



Certificato n. 176422, Rilasciato in data 15-09-2005

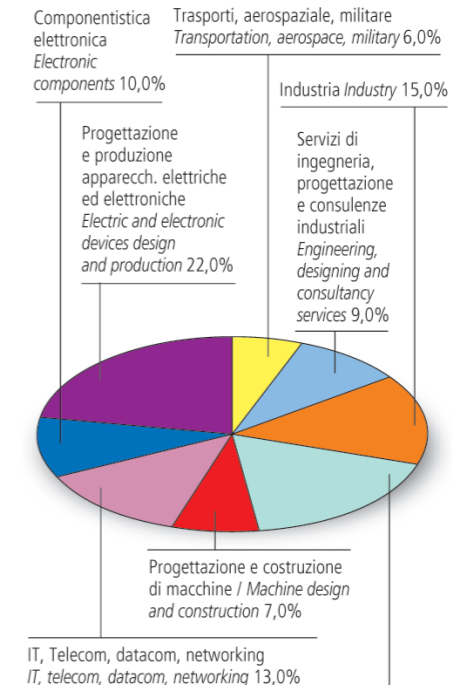
ELETTRONICA E AUTOMAZIONE | ELECTRONICS AND AUTOMATION



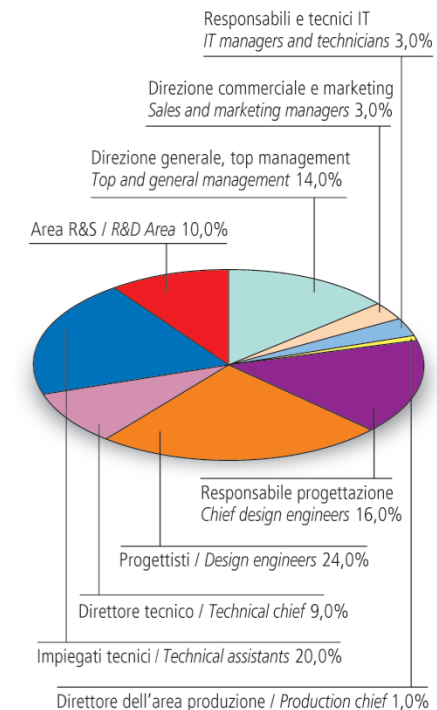
NUMERO ISSUE	SPECIALE COVER STORY	AGGIORNAMENTI UPDATE	ARTICOLI GENERALI GENERAL ISSUES	EDIZIONE ON LINE ON LINE EDITION www.ilb2b.it/elettronicaoggiweb.asp	FIERE EXHIBITIONS
385 Gennaio January	❑ Semiconduttori di potenza (Power semiconductors)	❑ MCU (MCUs)	❑ IC analogici/mixed signal (Analog Mixed signal ICs) ❑ Mems/sensori avanzati (MEMS/advanced sensors) ❑ Strumentazione T&M (T&M Instruments) ❑ Elettronica biologica (Biological electronics) ❑ Compatibilità elettromagnetica (EMC)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Trend nell'analogica (Digital trends)	
386 Febbraio February	❑ Soluzioni programmabili (Programmable solutions)	❑ Tool EDA (EDA tools)	❑ Potenza digitale (Digital power) ❑ Gestione termica (Thermal management) ❑ Elettromeccanici/Passivi/Connettori (Passive/electromechanics/Connectors) ❑ Nanotecnologie (Nanotechnology) ❑ Optoelettronica (Optoelectronics)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - R&D in Italia (R&D in Italy)	NI Days, febbraio, Milano Real Time and Embedded Computing Conference, Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA) ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, 01-06/02, Cancun (MEX) MC ² Motion Control, febbraio, (I)
387 Marzo March	❑ Evoluzione degli standard wireless (Wireless standards evolution)	❑ IC di alimentazione (Power supply ICs)	❑ Test RF (RF test) ❑ IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) ❑ IC condizionamento segnali/datapath (Signal management/datapath ICs) ❑ Logiche programmabili (Programmable logic) ❑ IC di interfaccia (Interface ICs)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - R&D in Europa (R&D in Europe)	Real Time and Embedded Computing Conference Marzo, Dallas / Houston (TX-USA) Embedded World, 03-05/03, Norimberga (D) CeBIT, 03-08/03, Hannover (D) Smart Systems Integration, 10-11/03, Bruxelles (B) EMV, 10-12/03, Stoccarda (D) PCIM China, 17-19/03, Shanghai (RPC)
388 Aprile April	❑ Nuove tecnologie per le batterie (New technology for battery)	❑ Tecnologie a larga banda (Broadband technologies)	❑ ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs) ❑ Integrità dei segnali (Signal integrity) ❑ Nanotecnologie (Nanotechnologies) ❑ Strumentazione T&M (T&M Instruments) ❑ TV digitale (Digital TV) ❑ Optoelettronica e fotonica (Optoelectronics & photonics)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Sotto i 45 nm (Below 45 nm)	Embedded Systems Conference - Silicon Valley, 14-18/04, San Jose (CA-USA) Display, 15-17/04, Tokyo (J) Hannover Messe, 20-24/04, Hannover (D) DATE, 20-24/04, Nizza (F)
389 Maggio May	❑ Strumentazione T&M - Directory (T&M Directory)	❑ Convertitori c.c./c.c. (c.c./c.c. converters)	❑ Interconnessioni seriali (Serial interconnections) ❑ Energie alternative (Alternative energy) ❑ Nuove tecnologie di memoria (Memory technology) ❑ Connessioni chip-to-chip (Chip-to-chip interconnects) ❑ ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Progettazione eco-compatibile (Environmentally friendly design)	SMT Hybrid Packaging 05-07/05, Norimberga (D) PCIM Europe, 12-14 /05, Norimberga (D) Enermotive, 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI) LinvinLuce 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)
390 Giugno June	❑ Microprocessori (Microprocessors)	❑ Standard wireless (Wireless standards)	❑ ID a radiofrequenza (Rfid) ❑ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ❑ MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors) ❑ IC alimentazione (Power supply ICs)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Architetture a bassa potenza (Low power architecture)	VforM-Vision for Manufacturing, giugno, (I) Laser World of Photonics, 15-18/06, Monaco (D) European Automotive Components Expo16-18/06, Stoccarda (D)
391 Luglio/Agosto July/August	❑ Nuove tecnologie (New technologies)	❑ Sistemi ATE (ATE systems)	❑ Elettromeccanici/passivi (Electromechanics) ❑ IC di conversione (Conversion ICs) ❑ Elettronica consumer (Consumer electronics) ❑ Software per la progettazione con Fpga (FPGA development software) ❑ Materiali per EMC (EMC materials)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Energie alternative: il ruolo dell'elettronica (Alternative energies: the role of electronic industry)	NI Week, agosto, Austin (TX-USA)
392 Settembre September	❑ IP/SoC (IPs/SoCs)	❑ DSP roadmap (DSP roadmap)	❑ Autenticazione e cifratura (Authentication & Encryption solutions) ❑ IC analogici/Mixed signal (Analog/Mixed signal ICs) ❑ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ❑ Nuovi materiali per l'elettronica (New materials for electronics) ❑ Integrati e componenti audio (Audio ICs and components)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Trend delle logiche programmabili (Logic programmable trends)	C ² -Control & Communication, settembre, (I) Embedded System Conference, settembre, Boston (MA-USA) Nanoforum, settembre, Milano (I)
393 Ottobre October	❑ Tecnologie di memoria (Memory technologies)	❑ Tecnologie a larga banda (Broadband technologies)	❑ Strumentazione T&M (T&M instruments) ❑ IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) ❑ Riutilizzo del design (Design reuse) ❑ Standard wireless (Wireless standards) ❑ Nanotecnologie (Nanotechnologies)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Progettazione a basso consumo (Low power design)	Microelettronica, 01-03/10, Vicenza (I) Semicon Europe, 06-08/10, Stoccarda (D) SAME, 07-08/10, Sophia Antipolis (F)
394 Novembre November	❑ Strumentazione EDA (EDA tools)	❑ Tecnologie di compressione (Compression technologies)	❑ ASIC/FPGA (ASICs/FPGAs) ❑ Controllo motori (Motor control) ❑ TV digitale (Digital TV) ❑ Semiconduttori discreti (Discrete semiconductors) ❑ Progettazione ESL (ESL Design)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - Evoluzione delle tecnologie di memoria (Memory technology evolution)	Focus Embedded, novembre, (I) Productronica, 10-13/11, Monaco (D) SPS/IPC/Drives, 24-26/11, Norimberga (D)
395 Dicembre December	❑ Tecnologie di conversione (Conversion technologies)	❑ Mcu Multicore (Multicore Mcu)	❑ Strategie di collaudo (Test strategies) ❑ Energie alternative (Alternative energy) ❑ Strumentazione T&M (T&M Instruments) ❑ Tecniche di coprocessing (Co-processing techs) ❑ Standard wireless (Wireless standard)	❑ Design ideas ❑ Hot news ❑ Web Exclusive - 2009: trend tecnologici nell'industria elettronica (2009: technology trends in electronic industry)	

CHI LEGGE ELETTRONICA OGGI READERS OF ELETTRONICA OGGI

Settori di interesse Fields of interest



Funzione aziendale Job function



Formati	Formats	Euro 4/c	Euro b/n b/w
1/4 pagina	1/4 page	880,00	646,00
1/3 pagina	1/3 page	1.027,00	823,00
1/2 pagina	1/2 page	1.996,00	1.351,00
2/3 pagina	2/3 page	2.231,00	1.645,00
Pagina	Page	2.767,00	2.055,00
Master	Master	8.083,00	-
I romana	Third page	3.212,00	3.212,00
Doppia mezza	Double half page	3.993,00	2.701,00
II copertina	Inside front cover	3.439,00	-
III copertina	Inside back cover	2.846,00	-
IV copertina	Back cover	5.039,00	-
Doppia pagina	Double page	5.534,00	4.111,00
Cartolina	Post card	1.800,00	1.800,00
Battente cop.	Cover leaf	6.522,00	-
Inserto 2 facciate	Insert 2 front	2.500,00	2500,00
Inserto 4 facciate	Insert 4 front	4.100,00	4100,00
Supplemento colore	Colour supplement	+20%	+20%
Posizioni speciali	Special position	+15%	+15%

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date

Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

Periodicità Frequency

Mensile 11 numeri (numero unico Lug/Ag)
Monthly 11 issues (July/August: combined issue)

Data pubblicazione Issue date

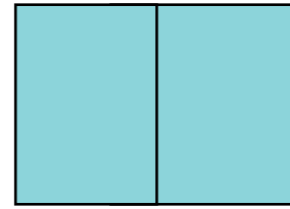
1° settimana del mese
First week of each month

Tipo di stampa Printing process

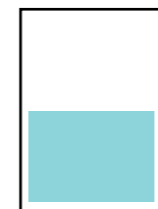
Offset piana
Web offset

FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

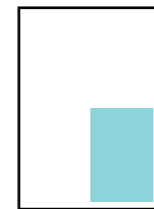
EO NEWS



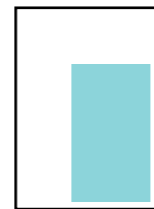
1/2 PAGINA VERTICALE
1/2 PAGE VERTICAL
132 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 262 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



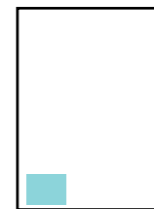
1/2 PAGINA ORIZZONTALE
1/2 PAGE HORIZONTAL
265 X 154 mm
+ REFILI / BLEED
235 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



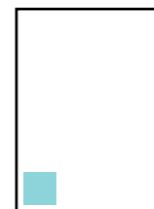
1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
133 X 155 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



JUNIOR / JUNIOR
154 X 201 mm
+ REFILI / BLEED
140 X 183 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



MANCHETTE 1° COPERTINA
79 X 61 mm
MANCHETTE NEWS
91 X 61 mm

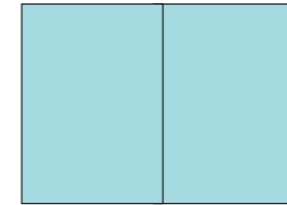


SPAZIO MERCATO
78 X 78 mm

DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA

FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
420 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
90 X 240 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
180 X 125 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm
SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED